

2023成都国际半导体与5G应用展览会

产品名称	2023成都国际半导体与5G应用展览会
公司名称	利欧展览（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南虹路5,9,15号5幢2515室
联系电话	17521330778

产品详情

2023成都国际半导体与5G应用展览会

时间：2023年7月13-15日

地点：成都世纪城新国际会展中心

展会简介

半导体是当今信息技术产业高速发展的源动力，已广泛渗透与融合到国民经济和社会发展的每个角落，是《中国制造2025》的重要组成部分，是实现数字中国和智慧社会发展战略的支撑力量。作为全球制造业的重镇，我国集成电路市场规模已达到万亿元级。《国家集成电路产业发展推进纲要》提出：至2021年，半导体产业与国际先进水平的差距逐步缩小；到2030年，半导体产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际梯队，实现跨越发展。

随着数字中国和智慧社会战略目标的加快推进，国家促进集成电路产业政策环境不断完善，以协同创新、开放合作、智能应用、深度融合为特征的中国半导体产业正呈现出全新格局，产业平稳快速增长，技术创新持续活跃，兼并重组不断深入，产融结合日益密切，市场需求广泛拓展，国际联动发展显著。国家集成电路产业投资基金撬动作用显现，地方性基金相继设立，有效带动一批重点项目投资

。展望“十三五”，全球集成电路产业进入深度调整与转折期，这是中国集成电路产业实现“华丽转身”的重要机遇期。

市场推动产业发展，应用技术创新。2023成都国际半导体与5G材料展览会将于2023年7月13-15日在成都世

纪城新国际会展中心召开，展会依托中国电子展强大行业资源集群效应，吸引了来自国内外的企业展示其新成果及创新应用案例。为从事集成电路设计、芯片加工、封装测试、半导体专用设备和材料、智能芯片开发与应用集成、智能硬件设计与制造的海内外厂商及企事业单位搭建了一个展示新技术、新产品、新应用、新品牌，探讨新市场、新趋势、新政策的综合平台，成为我国制造强国、网络强国等国家战略的前沿技术阵地和产业风向标旗帜。

展览会亮点

- 1.覆盖半导体领域全产业链，聚焦行业应用，为制造商提供新思路及解决方案，终端买家对接。
- 2.依托电子展资源带来强大科研购买力，汇聚高校，科研院所，重点实验室，工程中心，技术开发机构。将技术推向市场，帮助企业提升技术创新能力，解决新产品开发的关键技术，全新科技服务模式助力科技成果转化及产业升级。
- 3.将技术推向市场，帮助企业提升技术创新能力，解决新产品开发的关键技术，全新科技服务模式助力科技成果转化及产业升级。
- 4.高端论坛聚焦前沿，论坛水准及规模得到业内极大认可，内容覆盖半导体、5G技术、芯片技术、智慧感知、激光技术与材料加工、红外技术、智慧驾驶等。来自不同行业听众将带来各种应用需求。

观众

- 1.航空航天，船舶制造，汽车工程，仪器设备工程技术，通用工程技术，电子电气行业，IT产业，通讯行业，医疗，化工，石油煤炭、能源、冶金、机床等。
- 2.科研院所、高校、研发机构、行业协会、产业联盟、工业园区、高新区、产业基地、孵化器机构等。
- 3.国家有关部委及各省市政府、各驻中国商会、行业协会商会、进出口贸易公司、投融资机构等。

展示范围：

半导体设计、封测、制造生产厂商。

原材料：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、光掩模版、电子气体及特种化学气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料；

生产设备：单晶炉、氧化炉、扩散设备、离子注入设备、PVD、CVD、光刻机、蚀刻机、抛光机、倒角机、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备、单晶片沉积系统、清洗设备；

封装工艺及设备：减薄机、划片机、贴片机、焊线机、塑封机、打弯设备、分选机、测试机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备等；

测试与封装配套产品：探针卡、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液，划片液、封片膜(胶)高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板，焊线、流量控制、石英石墨、碳化硅等；

5G材料展区

5G高频高速材料及加工设备：陶瓷滤波器、陶瓷粉体、抛磨设备、导电银浆、烘银烧银设备等；覆铜板：PTFE、碳氢树脂、LCP液晶高聚物、PPO/PPE等；天线：PI、MPI、PPA、LCP、PPS、反射板精密加工设备等；5G光纤光缆、光模块光器件、连接器等使用的各种改性塑料等。

导热散热材料膜：石墨散热膜、石墨烯散热膜等；涂料：石墨烯、碳纳米管、氧化铝等填充的高导热涂料等；结构材料：铜、高导热铝合金、高导热镁合金、高导热塑料、陶瓷等；界面材料：导热硅脂、导热硅胶、双面胶、导热垫片、导热凝胶、液态金属、相变材料等；散热器件及模组：热管、散热板、风扇、散热片、热电转换等。

电磁屏蔽材料金属类：镀铜、不锈钢等；填充类：导电硅胶、导电塑料等；表面敷层类：导电布、导电涂料等；器件及模组：导电塑料器件、导电硅胶、导电布衬垫等。

防水材料：主板防水、器件防水、结构防水等。

特殊功能：光电、胶黏、除味、自清洁、易清洁、不沾、耐磨、耐高温等。